

# XBee® Wi-Fi

組込みWi-Fiモジュール for OEM

組込みWi-Fiモジュール「XBee Wi-Fi」は、フレキシブルなXBeeのハードウェアとソフトウェアのフットプリントで、低出力の802.11b/g/n通信を提供します。



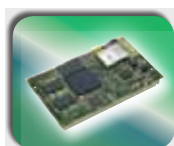
## Overview

XBee Wi-Fi組込みRFモジュールは、シンプルなシリアル to IEEE 802.11の接続性を提供します。ワイヤレスデバイスネットワークの低出力/低コスト要件を802.11の実績のある基盤で満たすことによって、XBee Wi-Fiはエネルギー管理、プロセスおよびファクトリオートメーション、ワイヤレスセンサネットワーク、インテリジェントな資産管理、その他の新たなワイヤレスのチャンスを開出します。これらのワイヤレスデバイスネットワークの厳しい要件にフォーカスすることで、XBee Wi-Fiは開発者にIP to デバイスの能力を提供します。

XBeeモジュールは、開発者に大きな柔軟性を提供します。XBee Wi-Fiは、他のXBeeモジュールとフットプリントを共有します。これにより、異なるXBeeのテクノロジーを相互にドロップ・イン(置くだけ)で置き換えることができます。例えば、802.11から802.15.4、ZigBee、DigiMeshや専用のロングレンジに、最小の開発期間とリスクで変更することが可能です。

XBeeファミリの1つとして、XBee Wi-Fiはハードウェアとソフトウェアを融合し、完全なモジュールソリューションを実現しています。XBee Wi-Fiモジュールは、既存の802.11インフラストラクチャのアクセスポイントと通信できるよう設計されています。開発者は、先進のコンフィグレーションオプションを実現するためにATおよびAPIコマンドが使用できます。

### 関連アイテム



Wi-Fi System-on-Modules



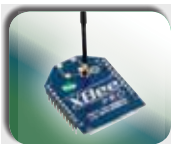
Wi-Fi Modules



iDigi® Solutions



Wireless Serial Servers

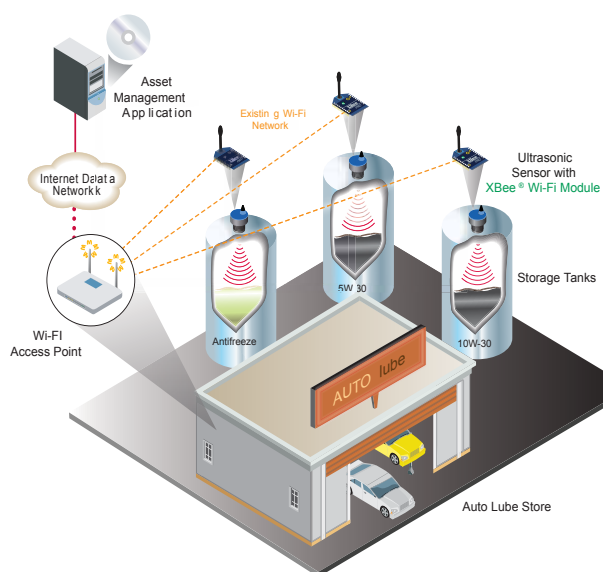


ZigBee Modules



Development Kits

### アプリケーションハイライト



### 機能と特徴

- ・ 共通のXBeeフットプリントにより、1つのフットプリントで各種のワイヤレスプロトコルをサポート可能
- ・ 柔軟なSPIおよびUARTシリアルインターフェース
- ・ RPSMA、PCB、U.FL、有線ホイップアンテナが選択可能
- ・ <math>2\mu\text{A}</math>パワーダウン電流により低電力スリープアプリケーションに対応
- ・ 最大65Mbpsの無線通信データレートを提供
- ・ 幅広い温度範囲 (-40°C~+85°C) により工業環境での動作を保証
- ・ 既存の802.11b/g/n基盤に容易に接続可能
- ・ シンプルなATやAPIコマンド経由による先進のコンフィグレーションオプションが利用可能



## 機能

シリアルデータインターフェース	UART to 1 Mbps、SPI to 3.5 Mbps
コンフィグレーション方法	API または AT コマンド
周波数帯域	ISM 2.4 GHz
ADC入力	4 (12ビット)
デジタルI/O	10
アンテナオプション	PCB (組込み)、U.FL、RPSMA、有線ホイップ
動作温度	-40°C ~ +85°C
外形寸法 (L×W)	2.438 cm x 3.294 cm

## ネットワークおよびセキュリティ

暗号化	WPA-PSK および WPA2-PSK
チャンネル	14 チャンネル

## 無線LAN

規格	802.11b/g/n
データレート	802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65 Mbps
変調	802.11b: CCK, DSSS 802.11g/n: OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
送信出力	802.11b: 16 dBm 802.11g: 16 dBm @ 6, 9, 12, 18 Mbps; 15 dBm @ 24, 36 Mbps; 14 dBm @ 48, 54 Mbps 802.11n: 16 dBm @ 6.5, 13, 19.5, 26 Mbps; 15 dBm @ 39, 52 Mbps; 14 dBm @ 58.5, 65 Mbps
受信感度	802.11b (<8% PER): -97 dBm @ 1 Mbps; -93 dBm @ 2 Mbps; -89 dBm @ 11 Mbps 802.11g (<10% PER): -91 dBm @ 6 Mbps; -75 dBm @ 54 Mbps 802.11n (<10% PER): -72 dBm @ 65 Mbps

## 電力条件

供給電圧	3.1 ~ 3.6V
送信電流	最大260 mA
受信電流	140 mA
パワーダウン電流	<2 µA @ 25°C

## 規制認可

FCC (アメリカ)	○
IC (カナダ)	○
CE / ETSI (ヨーロッパ)	申請中
C-TICK (オーストラリア)	申請中
Telec (日本)	○

M2Mネットワークを実現するための製品とテクノロジーを提供します

## ディジ インターナショナル株式会社

〒150-0031

東京都渋谷区桜丘町22-14 NESビルS棟8F

TEL:03-5428-0261 mail@digi-intl.co.jp

www.digi-intl.co.jp

© 2011 Digi International Inc.

●記載した仕様は予告なく変更する場合があります。●Digi, Digi International, Digiロゴ, the Making Wireless M2M Easyロゴ, DigiMesh, XBeeは、Digiインターナショナルの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。●ARMはARM社の登録商標です。●その他のすべての社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。●製品の仕様などの情報は予告なく変更する場合があります。

2012/02(改)



BUY ONLINE • [www.digi-intl.co.jp](http://www.digi-intl.co.jp)

